

PEEK Solvay per film ultrasottili

Shin-Etsu Polymer utilizza il tecnopolimero KetaSpire per estrudere film per diaframma di casse acustiche e altoparlanti di device mobili.

20 giugno 2017 08:00

La società giapponese Shin-Etsu Polymer sta utilizzando il PEEK KetaSpire di Solvay per estrudere film tecnici ad alte prestazioni e basso spessore (da 3-9 μm) commercializzati con il marchio Shin-Etsu Sepla Film, utilizzati per produrre il sottile diaframma degli altoparlanti di tablet, smartphone e casse audio, oltre che per cuffie e microfoni.



Il PEEK offre una combinazione di proprietà meccaniche, termiche, purezza, ritardo di fiamma, resistenza a fatica e all'abrasione che soddisfano i severi criteri richiesti dal gruppo giapponese per i suoi film Sepla.

La tecnologia sviluppata da Shin-Etsu Polymer consente di produrre film non stirati con spessori da 3-50 μm a 6-50 μm , sia a bassa che alta cristallizzazione. La società giapponese produce anche, su richiesta, film più spessi, fino a 250 μm . Per soddisfare la crescente domanda di film tecnici, Shin-Etsu Polymer ha recentemente installato una nuova linea di estrusione nell'impianto di Saitama, vicino Tokyo, capace di estrudere film con larghezza di 650-1300 mm.

© Polimerica - Riproduzione riservata